

# PALTEK

(証券コード:7587)

## 2020年12月期 第2四半期 決算説明資料

2020.8.6 (木)

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.



### 本資料取り扱い上の注意点

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

- ① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
- ② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合
- ③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
- ④ 為替相場の急激な変動
- ⑤ 新規仕入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
- ⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販売活動が及ばない地域へ移管された場合

- ① **2020年12月期 第2四半期  
業績結果**
- ② **2020年12月期 業績予想**
- ③ **今後に向けた取り組み**

①

**2020年12月期 第2四半期  
業績結果**

(百万円)	2019年第2四半期		2020年第2四半期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
売上高	14,794	100.0%	15,874	100.0%	1,080	7.3%
売上総利益	1,703	11.5%	1,925	12.1%	221	13.0%
販管費	1,641	11.1%	1,699	10.7%	58	3.6%
営業利益	61	0.4%	225	1.4%	163	264.7%
経常利益	62	0.4%	153	1.0%	91	146.3%
親会社株主に帰属する当期純利益	23	0.2%	143	0.9%	119	508.3%
1株当たり四半期純利益	2.15円	-	13.11円	-	10.95円	-

主な増減要因

- 売上高は、半導体事業およびデザインサービス事業が堅調なため増加
- 営業利益は、新規事業への投資などで販管費は増加するも、売上高増により増加

(百万円)	2019年第2四半期		2020年第2四半期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
半導体	13,473	91.1%	14,414	90.8%	941	7.0%
デザインサービス	867	5.9%	1,012	6.4%	144	16.7%
ソリューション	453	3.0%	447	2.8%	△5	△1.3%
売上高合計	14,794	100.0%	15,874	100.0%	1,080	7.3%

主な増減要因

- 半導体事業は、Q2においてFPGAビジネスで他代理店への顧客移管によるマイナスの影響があったものの、通信機器向けFPGA、海外の携帯情報端末向けのメモリ製品などが堅調に推移したため増加
- デザインサービス事業は、通信機器向けなどが増加
- ソリューション事業は、映像配信システムなどが引き続き堅調に推移

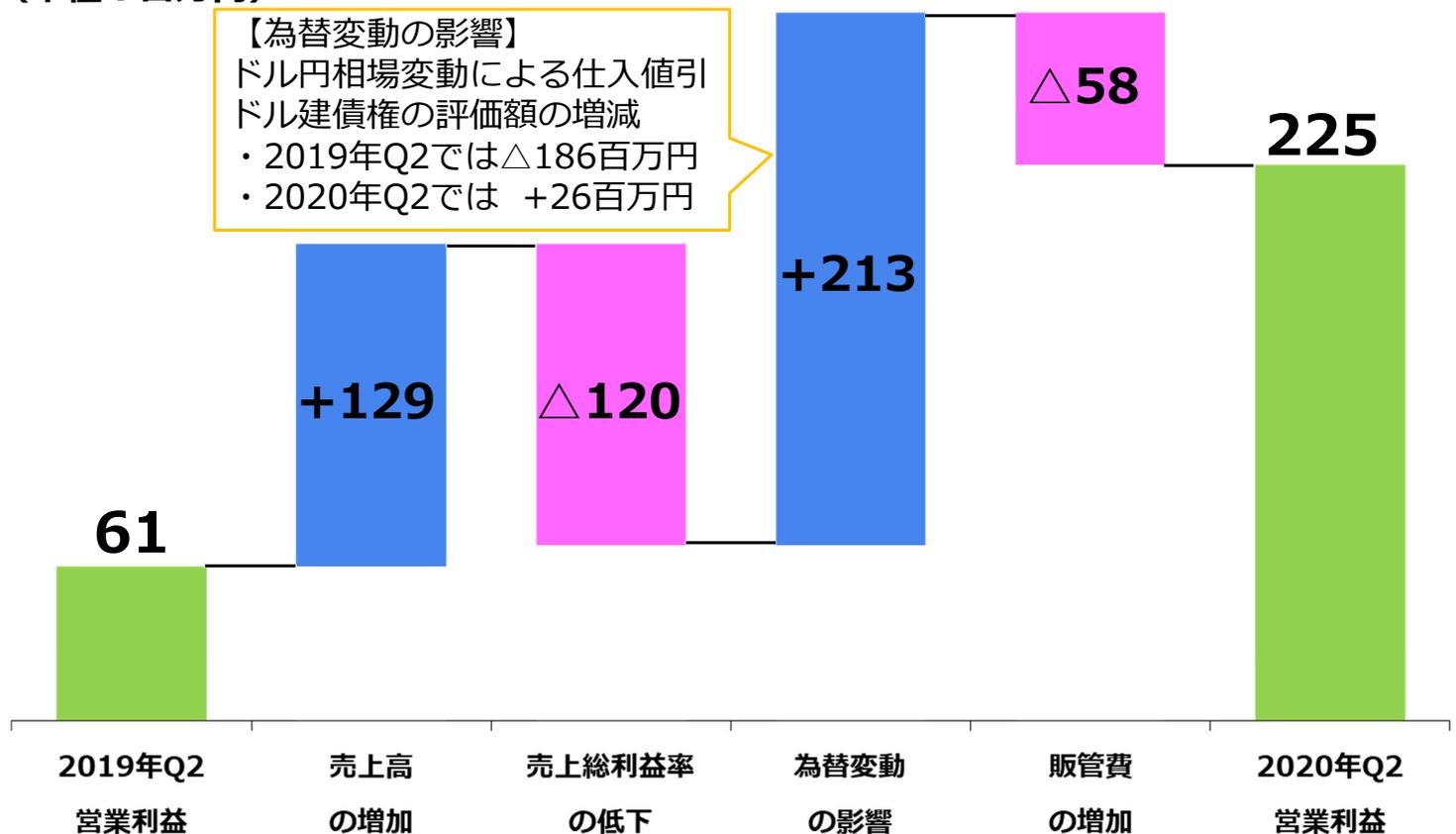
## ■ 売上総利益率の減少は、以下の2つが要因

- ドル円相場の変動により、仕入先に対して保有する仕入値引ドル建債権の評価額は変動。  
売上総利益に対する影響額は、  
2019年第2四半期では △186百万円 (△1.3%分)  
2020年第2四半期では +26百万円 (+0.2%分)

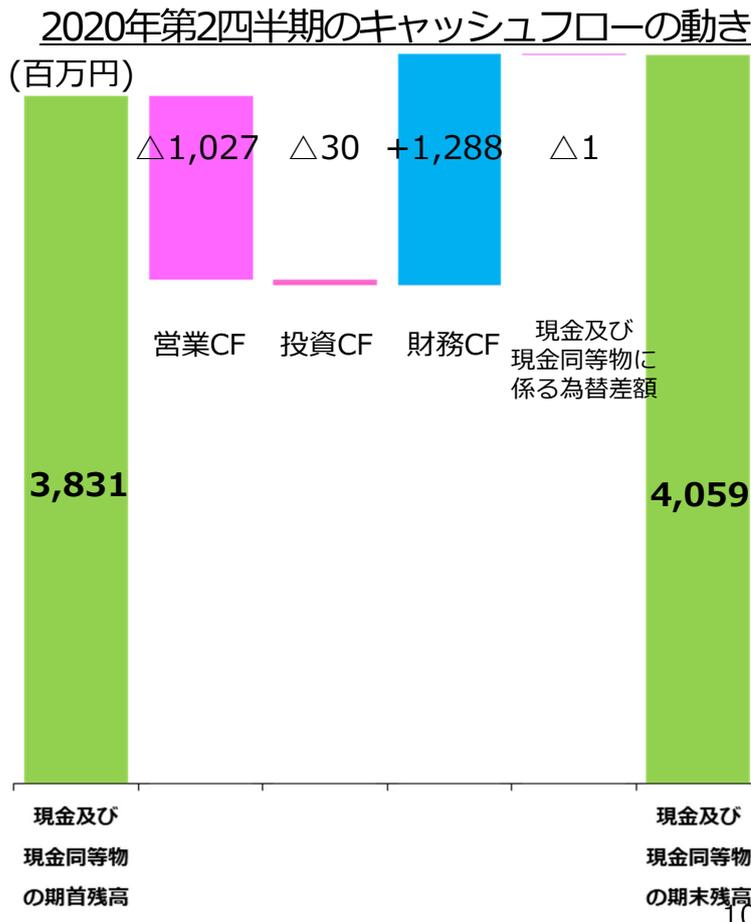
(百万円)	2019年第2四半期		2020年第2四半期	
	金額	対売上比率	金額	対売上比率
売上総利益	1,703	11.5%	1,925	12.1%
(うち為替の影響額)	△186	△1.3%	26	+0.2%
売上総利益 (為替の影響を排除)	1,889	12.8%	1,898	12.0%

- 半導体事業において、海外携帯情報端末向けの売上高が増加したことにより利益率が低下

(単位：百万円)



	(百万円)	2019.12	2020.06	増減額	主な増減理由
資産内訳	現金及び預金	3,831	4,059	228	
	売上債権	6,589	6,359	△230	
	商品	2,915	3,552	636	
	その他流動資産	2,177	2,769	592	未収消費税等が増加
	固定資産	556	585	29	
資産合計		16,069	17,326	1,257	
負債純資産内訳	仕入債務	863	1,251	388	
	短期借入金	3,680	5,080	1,400	仕入債務および輸入消費税の支払いに充当のため
	その他流動負債	1,775	1,195	△579	
	固定負債	219	235	15	
	純資産	9,531	9,564	△33	
負債・純資産合計		16,069	17,326	1,257	



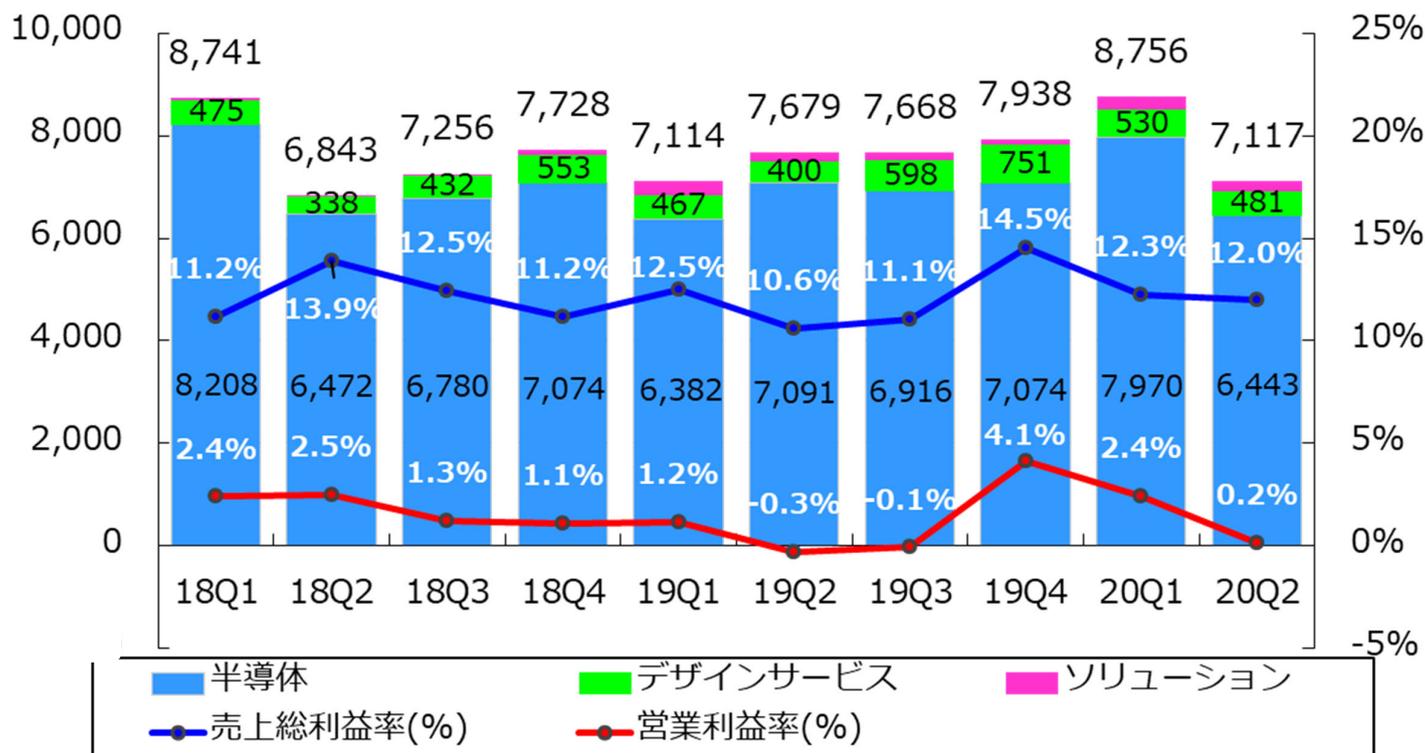
(百万円)	2019年 第2四半期	2020年 第2四半期
現金及び現金同等物の期首残高	2,024	3,831
営業CF	△170	△1,027
投資CF	△26	△30
財務CF	+738	+1,288
現金及び現金同等物の期末残高	2,571	4,059

## 2020年第2四半期キャッシュフローの動き

- 【営業CF】 売上債権および未収入金が減少した一方、たな卸資産および未収消費税等の増加などにより支出
- 【投資CF】 有形固定資産および無形固定資産の取得などにより支出
- 【財務CF】 配当金の支払いを実施した一方で、短期借入れの実施などにより収入

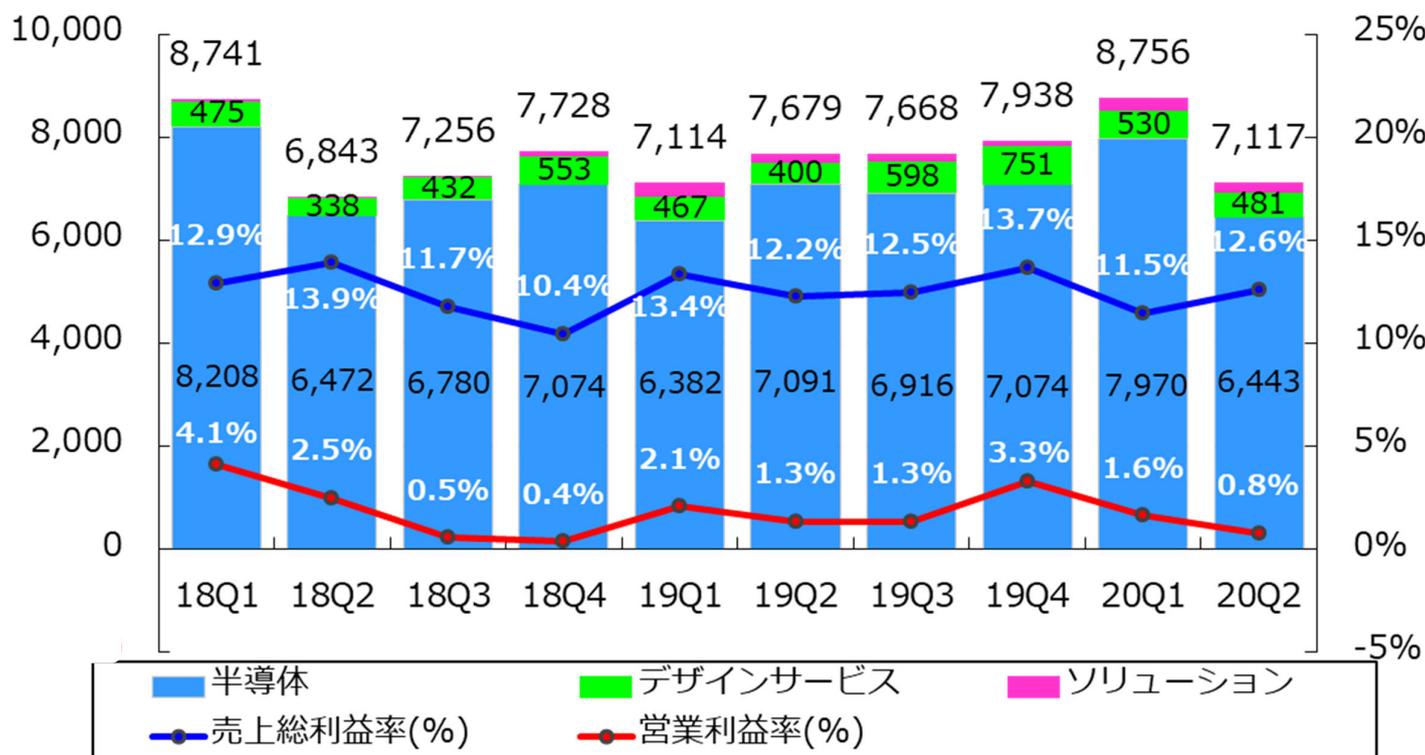
# 連結業績の四半期推移

(百万円)



# 連結業績の四半期推移 (為替の影響を除いた場合)

(百万円)



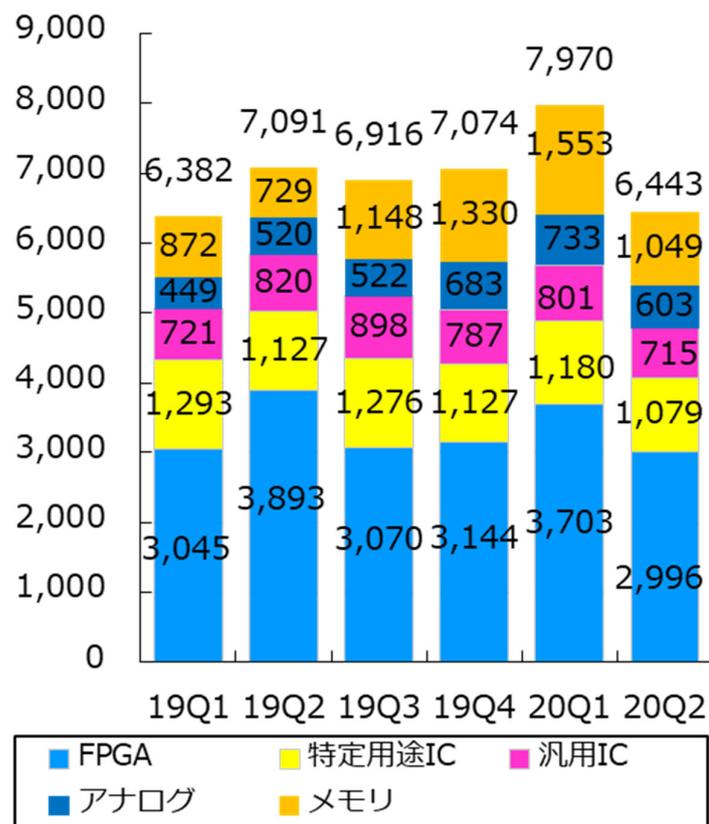
# 事業別の実績

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.



## 半導体事業の状況（製品別）

(百万円)

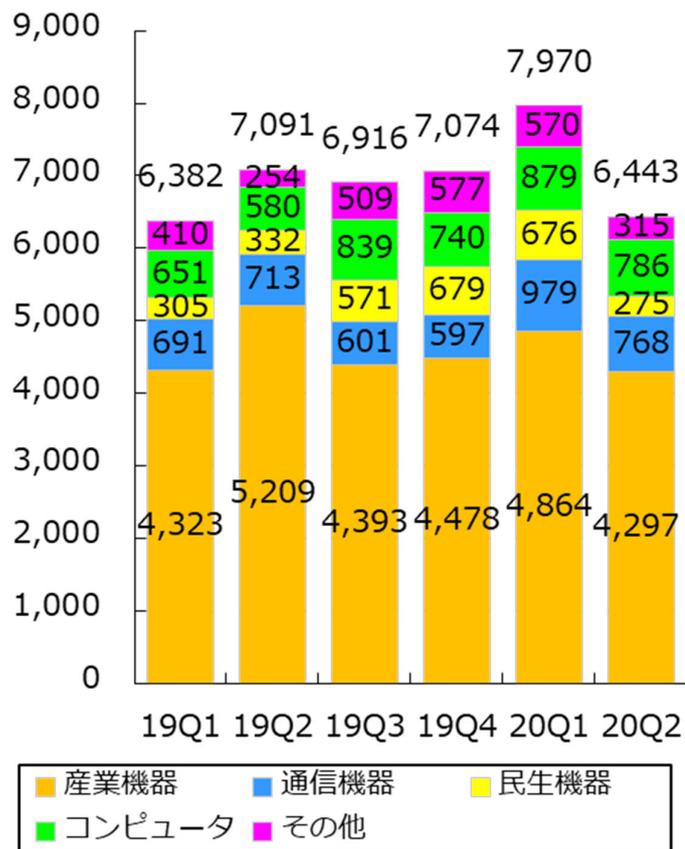


### 業績の推移

前四半期からの推移について

- **FPGA**  
通信機器、放送機器向けなどが減少  
また、他代理店への顧客移管の影響
- **特定用途IC**  
通信機器向けが増加するも、  
放送機器やPC向けなどが減少
- **汎用IC**  
ファクトリーオートメーション向け  
などが減少
- **アナログ**  
スーパーコンピュータやPC向けなど  
が減少
- **メモリ**  
海外携帯情報端末向けが減少

(百万円)

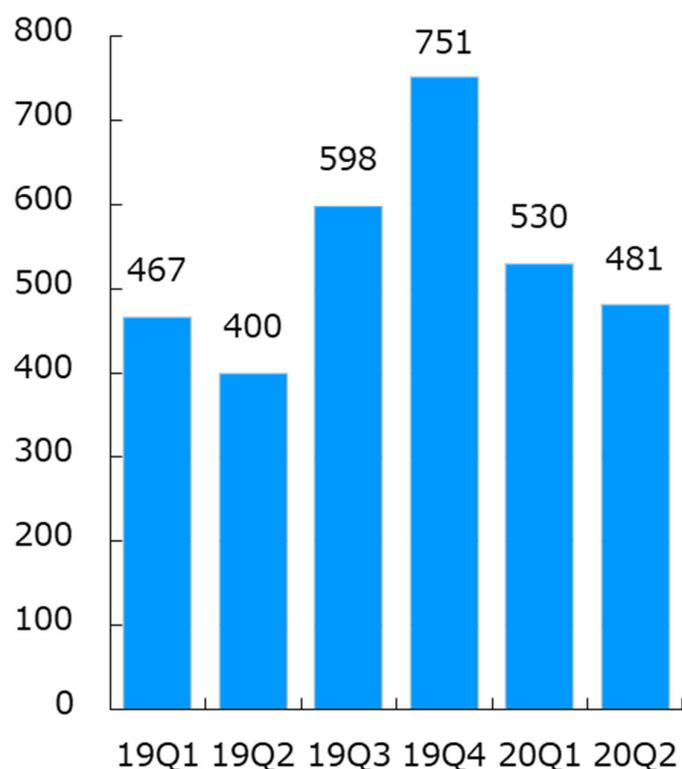


## 業績の推移

前四半期からの推移について

- 産業機器  
放送機器、ファクトリーオートメーション向けなどが減少
- 通信機器  
通信機器向けが減少
- 民生機器  
海外携帯情報端末向けが減少
- コンピュータ  
スーパーコンピュータ、PC向けが減少

(百万円)

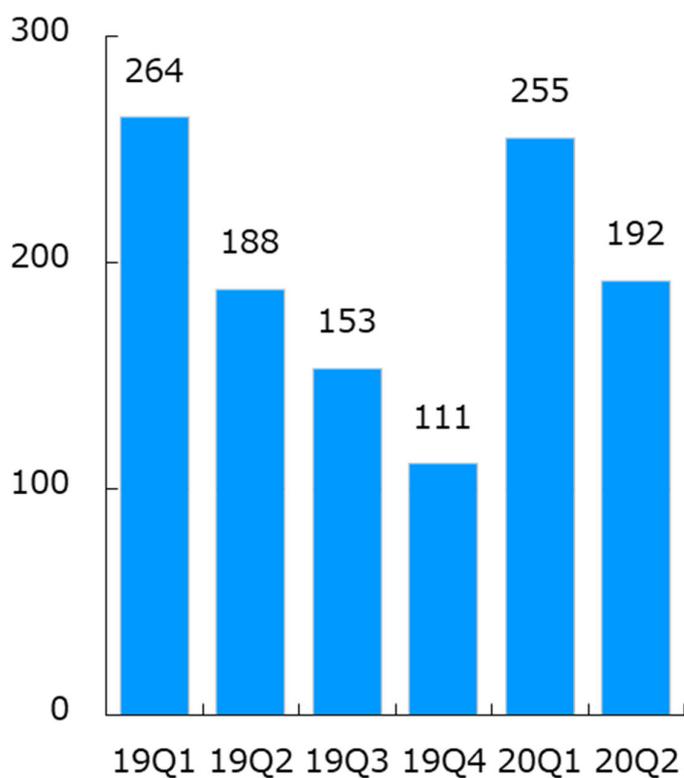


## 業績の推移

前四半期からの推移について

- 通信機器、産業機器向けが減少
- デザインサービス事業においては、お客様（3月決算会社）の予算との連動性が高いため、第2四半期の売上高は第1四半期に比べ、減少する傾向

(百万円)



## 業績の推移

前四半期からの推移について

- Q1で増加した映像配信システムが航空/宇宙分野向けに減少
- 紙梱包資材向けシステムや空間除菌システムが増加

2

## 2020年12月期 業績予想

通期業績については、今後の事業状況を見通すことが困難なため、現時点で修正は行わない

## ■ 第2四半期(累計)業績結果

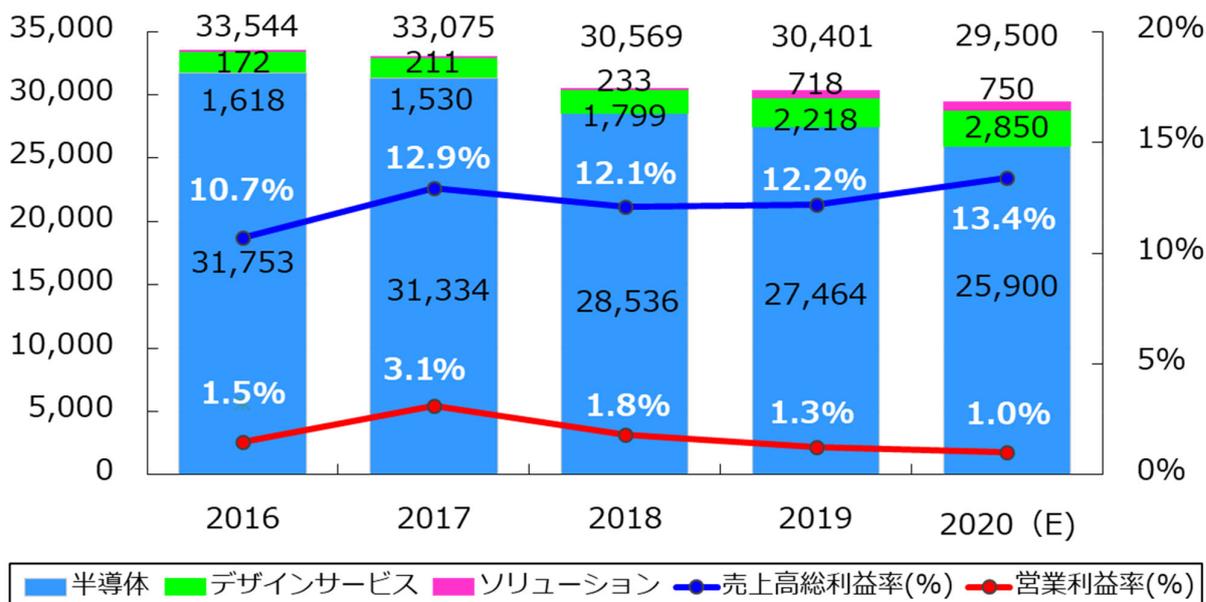
- 第2四半期(累計)業績は、6月26日に公表した業績予想修正どおりに推移

## ■ 通期の見通し

- 新型コロナウイルス感染症の影響がどれほどになるか現時点で見通すことが困難なため、現時点では通期業績予想の修正は行わない

(百万円)	2020年12月期 当初予想			2020年12月期 今回予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
売上高	14,000	15,500	29,500	15,874	13,625	29,500	-	-
売上総利益	1,850	2,100	3,950	1,925	2,024	3,950	-	-
売上総利益率	13.2%	13.5%	13.4%	12.1%	14.9%	13.4%	-	-
販管費	1,800	1,850	3,650	1,699	1,950	3,650	-	-
営業利益	50	250	300	225	74	300	-	-
営業利益率	0.4%	1.6%	1.0%	1.4%	0.5%	1.0%	-	-
経常利益	10	210	220	153	66	220	-	-
当期純利益	7	143	150	143	6	150	-	-

(百万円)



- 売上高 : デザインサービス事業が増加するものの、半導体事業が減少
- 売上総利益率 : 利益率の高いデザインサービス事業の売上高が増加するため上昇
- 営業利益率 : モビリティビジネス、AIソリューションなどの新規事業への人材投資を継続するため販売費及び一般管理費が増加し、営業利益率は低下

## ■ 半導体事業で想定される影響

- ・ ファクトリーオートメーション : 顧客の事業環境により異なるが、総じて設備投資に対し慎重な動き
- ・ 医療機器 : 大きな変動はなし
- ・ 通信機器 : 5Gインフラ向けは堅調
- ・ 放送機器 : 設備投資が大幅に減少
- ・ 計測機器 : 通信向けは堅調
- ・ 事務機器 : 先行き不透明

## ■ デザインサービス事業で想定される影響

- ・ 開発案件への投資が減少

## ■ ソリューション事業で想定される影響

- ・ 全般的に展示会出展の中止、顧客訪問が積極的に行えない状況が続き、営業活動への影響が大きく、新規顧客開拓が遅延

## ■ 新規ビジネスへの投資は継続

# 3

## 今後に向けた取り組み

## PALTEKの方向性

### ■ 経営方針

- ソリューションサプライヤーとして社会的意義ある価値を創出し、ニーズとシーズを照らし合わせた、付加価値の高い製品提案、ソリューションの開発・販売
- 収益性の高い経営を目指す

### ■ 各事業の方向性

#### ソリューション事業

基軸事業を活用し、市場ニーズに合ったソリューションを提供する事業

#### デザインサービス事業

半導体事業で積み重ねた強味を活かし、常に新しい技術を活用した開発力と設計品質の向上に努め、付加価値を高める事業

#### 半導体事業

成長市場に注力し、安定的に収益を上げていく基盤事業

半導体をベースにした営業力・提案力・開発力



無線通信技術



画像処理技術



制御技術

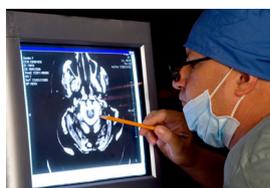


注力技術

5G、AI、IoT、ロボット、映像伝送、ADAS



産業機器



医療



放送・映像

25



公共インフラ



車載

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.

### 【事業環境】

- 5G、IoT、AIの活用により半導体市場が拡大
  - ネットワークの高速化に伴いエッジコンピューティングなどの活用が見込まれる
- 車載分野においては、自動運転の発展に伴い半導体市場は拡大

### 取り組み

- 5G、IoT、データセンター、エッジコンピューティング、AI使用関連市場に注力
  - ⇒ FPGA、メモリ、マイコン、電源などビジネス拡大
- ソリューション提案（新たな市場へ展開）
  - （例：エッジコンピューティング+AI..etc）

- 産業機器市場は、設備投資見直し等により先行き不透明
- 5G関連分野での新規案件増への期待

## PALTEK 取り組み

- ・ 既存顧客の提案/サポート力強化の継続
- ・ 新規市場/新規顧客の開拓
- ・ 新製品のプロモーション
  - ・ 自社にてリファレンスデザイン開発

<XILINX Solution>



<XILINX ALVEO Solution>



<VERSAL>

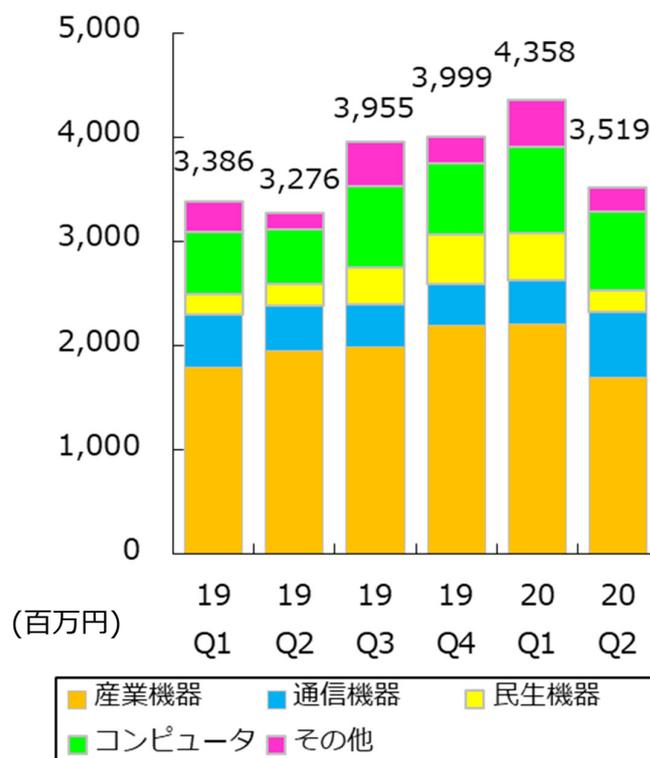


© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.

- 産業機器向け不透明な状況
- 既存顧客への深堀継続
- 成長市場へ新規案件活動継続
  - ・ 通信分野  
5G関連分野へ注力
  - ・ 産業機器
  - ・ データセンター/クラウド



## 売上高の推移



## 【事業環境】

- ・ 機器自体やそれを構成する半導体などが高機能化・高度化し、すべてをお客様のみで開発することが困難
- ・ お客様は社外リソースも活用し、製品リリースの早期化が必要

## 事業構成

- ・ 設計受託
- ・ ODM/EMS
- ・ 自社製品開発/販売

製品実現への提案

### 設計受託

システム設計  
ソフトウェア設計  
ハードウェア設計  
筐体(機構)設計

評価

生産

## 取り組み

- ・ 営業力の強化（ODM案件発掘に注力）
- ・ 開発人員の増強
- ・ 自社製品販売力の強化
- ・ 車載分野への自社製品開発販売&受託開発

## ■ 事業の状況

- ・ 医療機器、通信機器向けが堅調

## ■ 設計受託・ODMの今後の展開

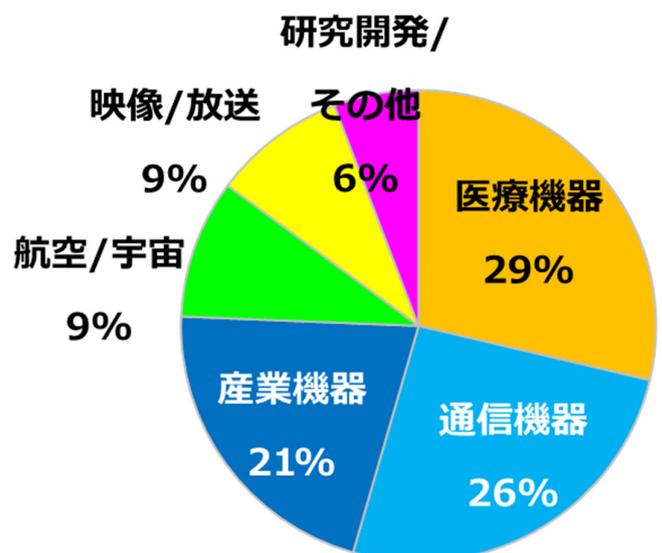
- ・ 新規案件受注獲得へ

## ■ 自社製品販売力強化

## ■ グループ会社での事業展開

- ・ エクスプローラ
  - 受託・ODM・自社製品販売強化
- ・ ウィビコム
  - 受託開発継続獲得へ

用途別売上構成  
2020年Q2（累計）



## ■ FPGAコンピューティング プラットフォーム「M-KUBOS」

- 5Gに必須となるエッジコンピューティングの高速処理などが実現可能



### M-KUBOSの活用例



スポーツイベント・ライブでの仮想現実 (VR/AR)



工場施設でのセンサデータ解析



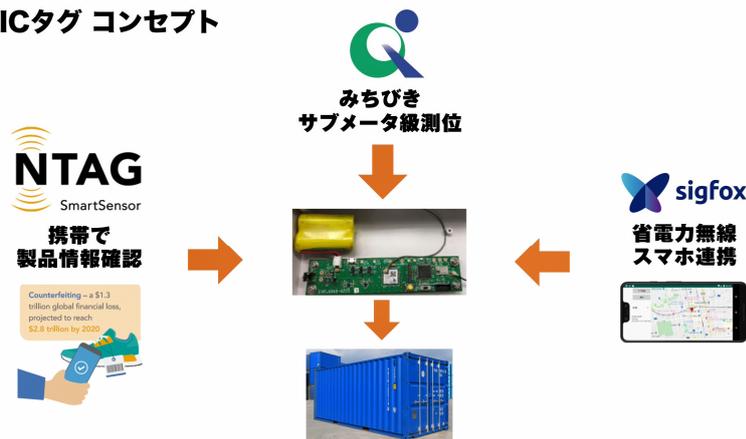
AIによる病巣の診断補助

# 準天頂衛星システム「みちびき」の サービス開発実証実験に参画

## ■ みちびきのサブメータ級測位補強サービスに対応した「無線ICタグ」および「駐車表示用スマホアプリ」による駐車位置確認システムの開発に成功

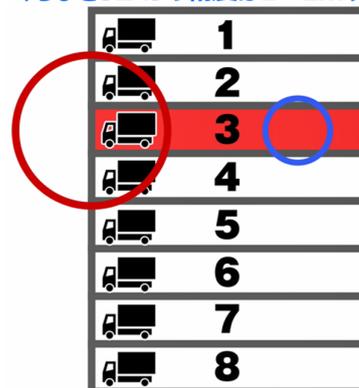
- 低消費電力・長距離伝送を特徴とする無線規格「Sigfox」を活用し、トレーラシャーシや物流コンテナに設置したまま3~5年程度の電池駆動を実現
- 社会実装を目指し製品化設計を行い、2020年中に量産出荷開始予定

無線ICタグ コンセプト



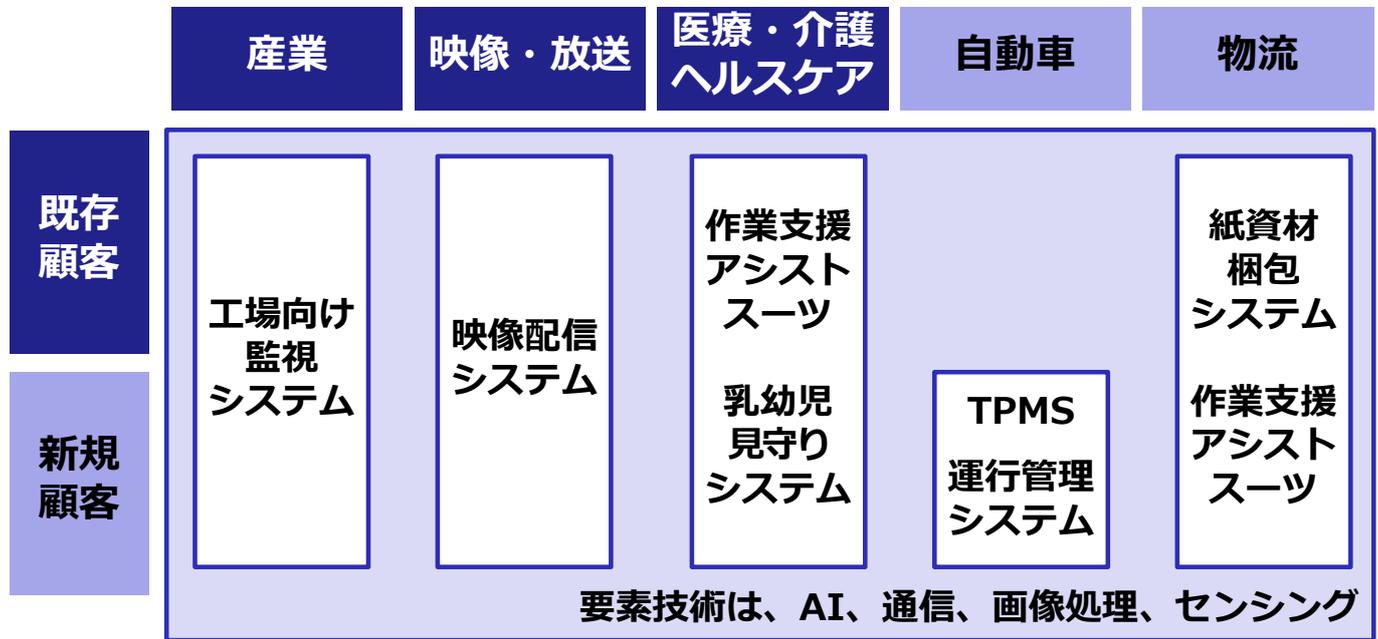
3つの技術の融合で物流管理コストを低減

GPSの精度は5~10m  
みちびきSLASの精度は1~2m以下



## ■ ソリューション事業の狙い

- 市場拡大が見込まれる分野に注力したソリューションを発掘・開発
- 将来的にIoTやサービス等の付加価値の可能性のあるソリューションを展開



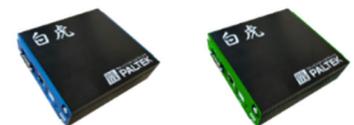
## 【事業環境】

- 自動運転システムは非常に複雑なシステム。高い安全性を求められ中で、システム検証は膨大な検証量/時間/コストを要する
- 開発支援をする上で、高速な検証装置(シミュレータ)が必要

## ■ ハードウェアエミュレータ「白虎」「MODEL CUBE」の販売

### <白虎>

- 車両運動モデル、バッテリーモデルはインストール済
- コンパクトサイズ超軽量 / 簡単操作・簡単設定



<車両運動モデル><バッテリーモデル>

### <MODEL CUBE>

- お客様の各種モデルを実装可能
- ファンレス、小型形状 / 簡単操作・簡単GUI
- リアルタイムシミュレーションをFPGAで実現



<MODEL CUBE>

車載メーカー&車載メーカー関連企業 複数社から引き合い

## ■ Haivision 社の4K対応小型IP映像配信装置を提供開始

### 【Haivision製品】

- Makito X4 ビデオデコーダ販売へ
- Makito X4 エンコーダ&デコーダ セット販売へ
- 販売分野：航空/宇宙・放送・医療・産業機器
- 医療分野へ展開 パートナーと連携強化



Haivision社製 映像配信装置



### 【エクスプローラ製品】

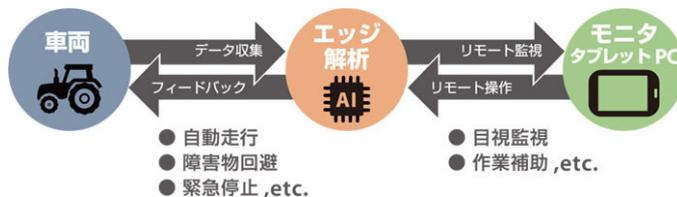
- 産業機器向け顧客へプロモーション継続

エクスプローラ製 映像配信装置

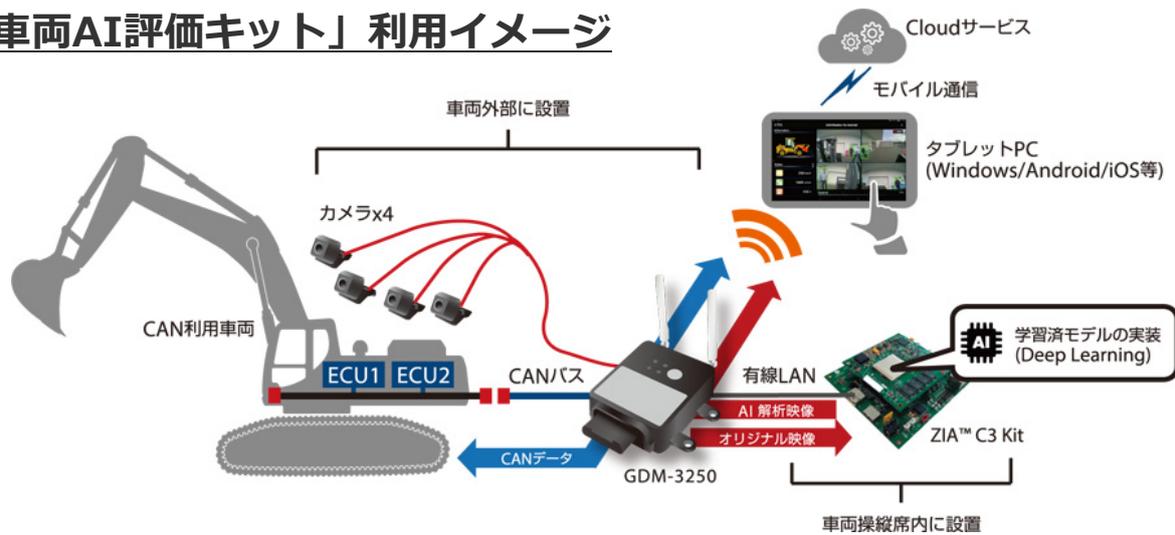


## ■ 農機・建機・搬送装置向け自動化ソリューション

- サイレックステクノロジー・DMPと共同で、農機・建機・搬送装置向け車両AI評価キット開発

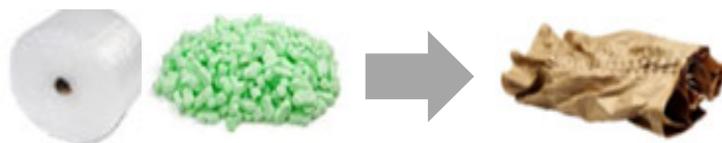


### 「車両AI評価キット」利用イメージ



## ■ ビジネスの位置づけ

- ・ 生態系への影響懸念により脱プラスチックが進む
- ・ 紙緩衝材の提案推進



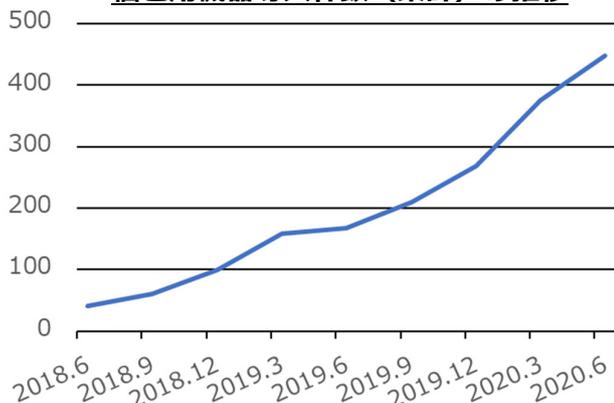
プラスチック系緩衝材

紙緩衝材

## ■ 展示会へ出展ができず新規顧客への提案が滞る

## ■ その中でもシステム導入件数は増加

梱包用機器導入件数（累計）の推移



37

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.

## ■ 数値目標（2022年度）

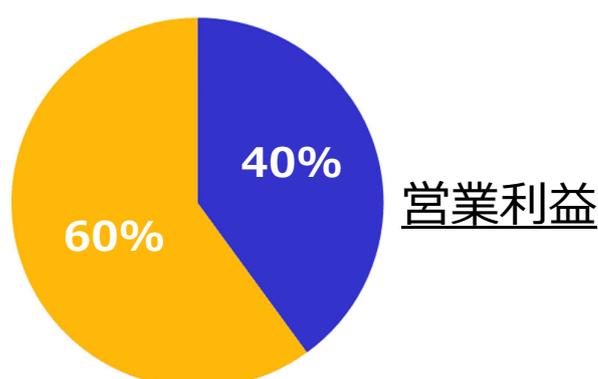
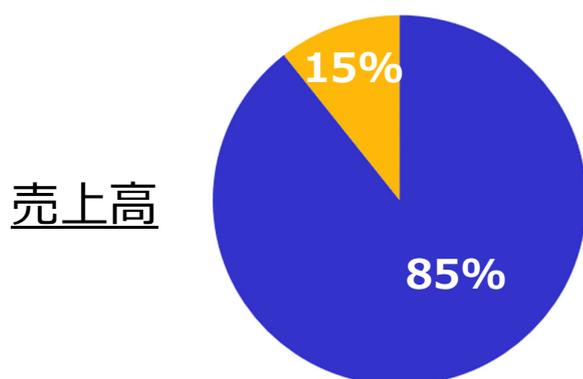
売上高

400億円以上

営業利益率

5%以上

2022年時の売上高/営業利益の構成イメージ



■ 半導体事業

■ デザインサービス事業 + ソリューション事業

38

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.

# 参 考 資 料

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.

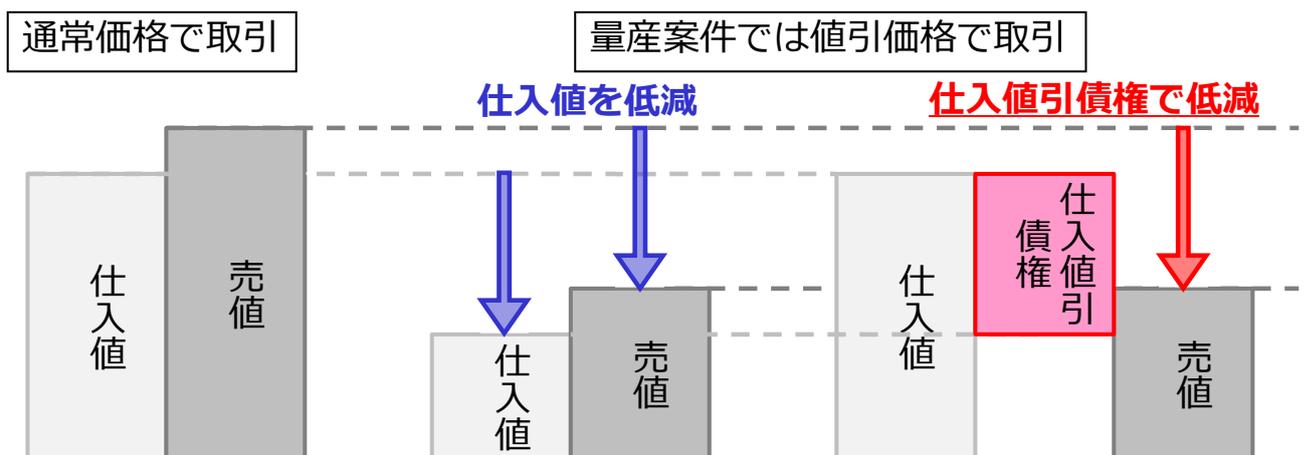
## 為替変動に関する影響

## ■ 為替変動により当社グループの利益は以下の4点で影響を受ける

- ① 仕入値引ドル建債権の為替変動による影響
- ② 調達在庫の為替変動による影響
- ③ 決済時のドル調達レート変動による影響
- ④ ドル建売掛金入金時のレート変動による影響

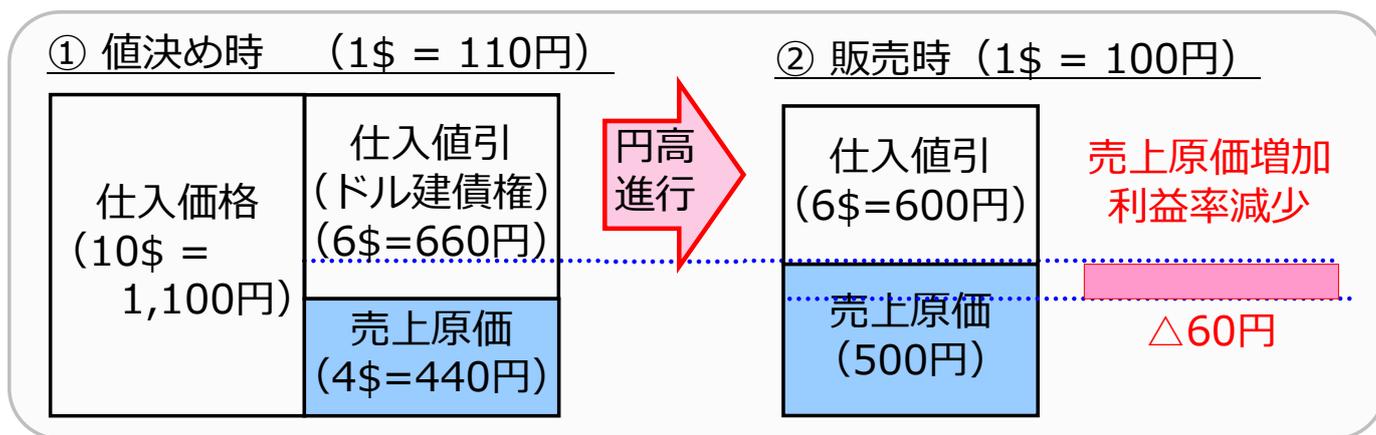
### 【仕入値引ドル建債権の為替変動による影響】

- 当社が仕入先に対して保有する『仕入値引ドル建債権』が、為替レートの変動により評価額が増減することで、業績に大きな影響を与える
- 仕入値引ドル建債権について：
  - ・ 量産案件によっては、通常価格よりも低い価格での販売を要請されることがある
  - ・ その場合、仕入先との間で仕入価格の低減交渉を行う
  - ・ その実現方法は、「仕入値自体の低減」と「仕入値引債権の付与による低減」



- 仕入値引債権の評価額の増減は、値決め時と販売時の為替レートの差により生じる
- そのため、急速に円高が進行すると、為替レートの差が大きくなるため、仕入値引債権の評価額が大幅に減少
- これにより、売上原価が増加し、売上総利益が減少

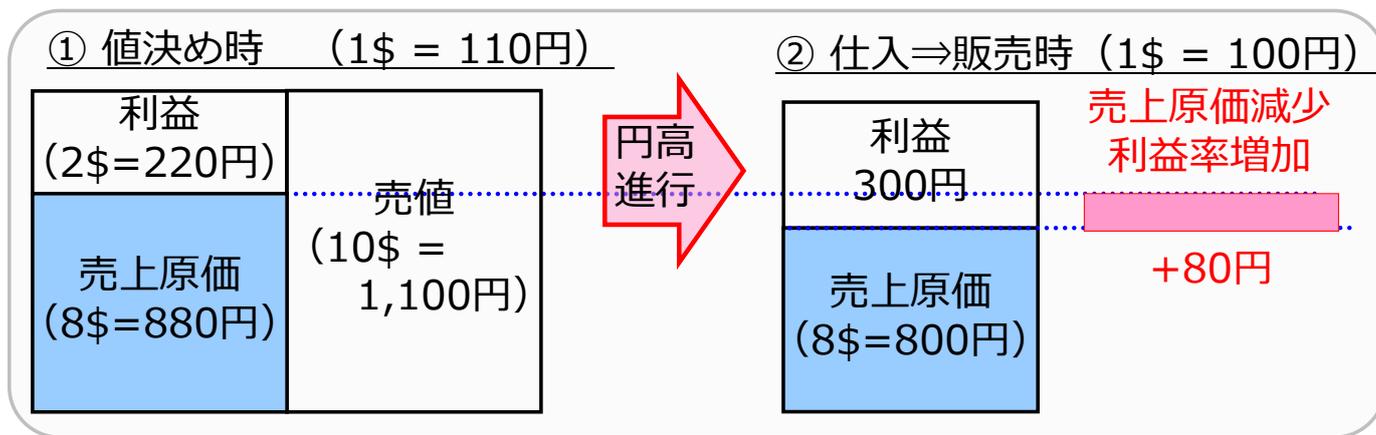
例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化



## 【調達在庫の為替変動による影響】

- 海外から仕入れたドル建の製品において、為替レートが円高に進行することにより、売上原価が減少し、売上総利益は増加

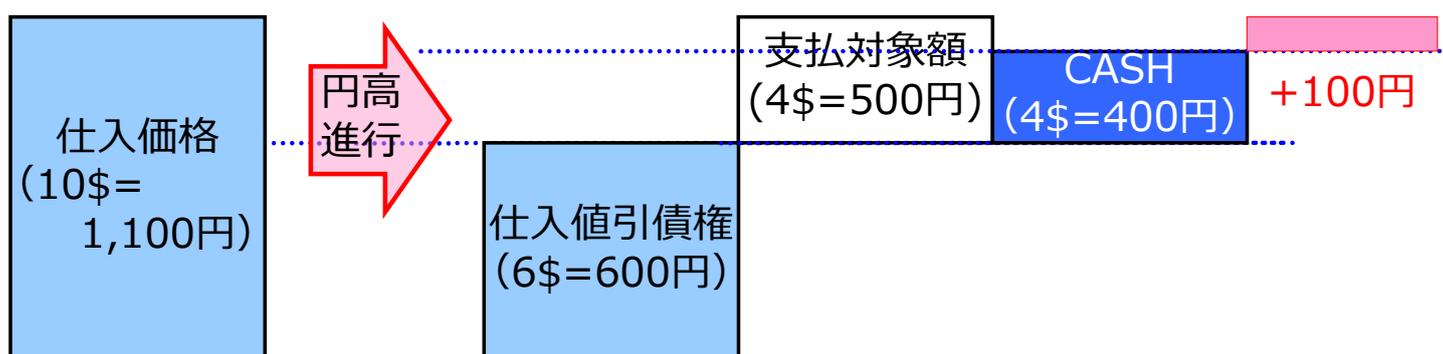
例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化



## 【決済時のドル調達レート変動による影響】

- 支払を行う際に円高に進行していた場合、ドルを調達する金額が少なくなるため、決済差額が生まれ、為替差益を計上することとなる
- 一方、円安に進行した場合は、為替差損を計上することとなる

① 仕入時 (1\$ = 110円) ② 販売・支払時 (1\$ = 100円)

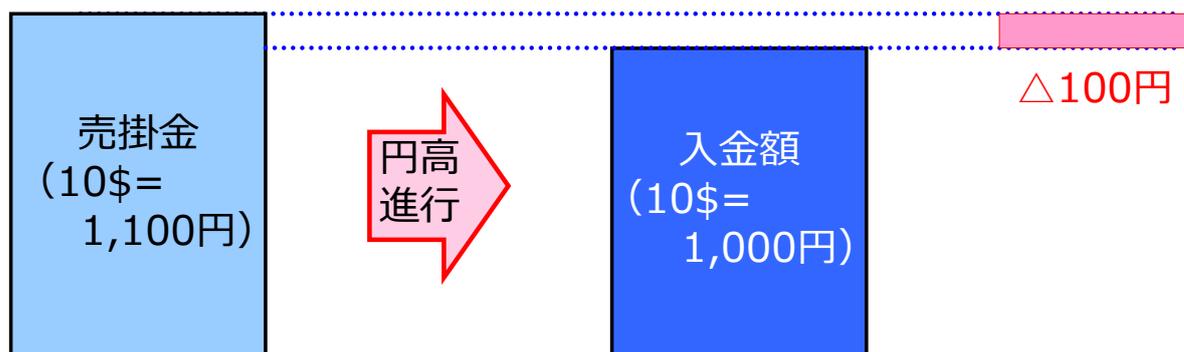


## 【ドル建売掛金入金時のレート変動による影響】

- ドル建売掛金の入金がある場合には、円高に進行するとマイナス、円安に進行するとプラスの影響が発生する（営業外の為替差損益）
- 当社はこのリスクを限定的にするために、為替予約を行っている

① 販売時 (1\$ = 110円)

② 入金時 (1\$ = 100円) 決済差額



## ■ 売上総利益への影響額

- Q2における評価レートは緩やかに円高方向で推移したため、為替変動の影響額はマイナス方向に

(単位：百万円)	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2
為替レートの変動 (円)	108→ 110	110→ (112)→ 107	108→ (106)→ 108	108→ (109)→ 108	108→(112 →101→ 111)→108	108→ (109)→ 107
為替変動の影響 (売上総利益)	-63	-124	-108	69	70	-43
仕入値引債権の評価額変動の影響	-396	60	-542	241	198	-503
調達在庫の為替レート変動の影響	333	-183	434	-172	-127	459

## ■ 営業外損益への影響額 (期末評価替の影響は含まず)

- 買掛金支払時のレート変動の影響は+19百万円

(単位：百万円)	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2
買掛金支払時のレート変動の影響 (営業外)	-15	122	64	-98	-26	19

- 売掛金受取時のレート変動の影響額は+9百万円

(単位：百万円)	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2
売掛金受取時のレート変動の影響 (営業外)	-42	-49	-61	-3	-20	9

(百万円)	2019年12月期 実績			2020年12月期 業績予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
半導体	13,473	13,991	27,464	14,414	11,485	25,900	△1,564	△5.7%
FPGA	6,938	6,215	13,154	6,699	4,300	11,000	△2,154	△16.4%
特定用途IC	2,421	2,404	4,825	2,259	1,740	4,000	△825	△17.1%
汎用IC	1,542	1,686	3,228	1,516	1,683	3,200	△28	△0.9%
アナログ	969	1,206	2,175	1,336	1,263	2,600	424	19.5%
メモリ	1,601	2,479	4,081	2,602	2,497	5,100	1,018	25.0%
デザインサービス	867	1,350	2,218	1,012	1,837	2,850	631	28.5%
ソリューション	453	265	718	447	302	750	31	4.3%
売上高合計	14,794	15,607	30,401	15,874	13,625	29,500	△901	△3.0%
営業利益	61	322	384	225	74	300	△84	△21.9%

開示区分	内容説明
半導体事業	半導体及び関連製品の販売、技術支援
FPGA	ザイリンクス社のFPGAを中心とするソリューション
特定用途IC	特定用途に特化した半導体を中心とするソリューション (例：通信向け、インタフェース向け、携帯端末向け等)
汎用IC	NXPセミコンダクターズ社、マイクロチップテクノロジー社等の汎用ICを中心とするソリューション
アナログ	アナログ半導体を中心とするソリューション
メモリ	マイクロンテクノロジー社等のメモリを中心とするソリューション
デザインサービス事業	受託開発、ODM/EMS/OEM
ソリューション事業	最終製品レベルでのソリューション提案を実施 自社製品（ハードウェア、ソフトウェア、システム）の 開発・販売

以下の担当までお問い合わせ下さい。

### 株式会社PALTEK

柴崎 由記 (IR担当)

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル

TEL : 045-477-2016

FAX : 045-477-2012

E-mail : ir@paltek.co.jp